東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ 主要装置リスト (2021年4月~)

■施設使用料(1人あたり) 学外:960円/時間、学内:790円/時間 (改定前 学外:990円/時間、学内:820円/時間)

■技術支援料 6,514円/時間 (ナノテクノロジープラットフォームご利用の場合、3,300円/時間)

(改定前と同じ)

分類	番号	装置名称	メーカ/型番	公開利用 使用料 (円/時間)	非公開利用 使用料 (円/時間)	改定前使用料	対応ウェハサイズ	備考/簡単な仕様、装置の特徴等
	A-01	エッチングチャンバー	アズワン PSH1200	1,290	1,548	1,110	最大8インチ	酸洗浄、ウェットエッチング(Si, SiO2, 金属など)
	A-02	リン酸槽		1,730	2,076	1,440	最大8インチ	SiNウェットエッチング
洗	A-04	イナートオーブン(シンター炉)	ヤマト科学 DN63H	1,710	2,052		最大6インチ	N2雰囲気中での熱処理、Alシンタリングなど
浄	A-05	真空オーブン	ヤマト科学 DP-31	994	1,192		最大8インチ	真空中での熱処理
乾		ブラシスクラバ	全協化成	6,906	8,286		最大6インチ	研磨後のウェバ洗浄
燥		スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4	2,428	2,914		最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
	-	有機ドラフトチャンバー	051175001 000101	1,290	1,548		最大6インチ	有機洗浄、レジスト剥離
	-	4"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	2,612	3,134	2,116		カセット式で1度に25枚まで処理可能
		6"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	2,612	3,134	2,116		カセット式で1度に25枚まで処理可能
	-	スピンコータ	ミカサ 1H-DXII	2,170	2,604		最大4インチ	レジスト等のスピンコーティング
		クリーンオーブン	ヤマト科学 DE62	2,830	3,396		最大8インチ	ウェハのベーク
		ポリイミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H	1,872	2,246		最大8インチ	N2雰囲気中でのポリイミドのキュア
	B-05 B-08	両面アライナ	Suss MA6/BA6	3,240	3,888		最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント レジスト現像用のドラフトチャンバー
		現像ドラフト UV キュア装置	ウシオ電機 UMA-802	1,290 4,120	1,548 4,944	3,270		レジストのキュア、カセットtoカセット
		スピンコータ	アクテス ASC-4000	2,332	2,798		最大6インチ	レジスト等のスピンコーティング
IJ		スプレー現像装置		2,332	2,798		最大6インチ	+
ソ	B-11 B-13		アクテス ADE-3000S エリオニクス ELS-G125S				最大6インチ	現像液とリンス (水) をノズルから噴霧 最大加速電圧: 130keV、最小描画パターン: 10nm以下
グラ		エリオニクス EB描画装置	Heidelberg Instruments	9,422	11,306			波長:405nm、最小描画線幅:0.7µm、マスク作製(Cr、エマルジョン)、直接描画、グレ
7	B-14	レーザ描画装置	DWL2000CE	7,094	8,512	6,988	最大9インチ角	イスケール露光
1	B-15	球面露光装置	東栄科学産業	4,450	5,340	4,438	球面体	球面体 (直径1.0、3.3mm) へのマスクレス露光、最小パターン: 1.5µmハーフピッチ、アライ
		スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4	2,208	2,650	2 010	最大6インチ	メント精度: ±5µm 平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
		ホットプレート	Shamal HHP-230SQ	994	1,192		最大8インチ	設定温度: 40~400℃、温度分布精度: ±1℃
			Heidelberg Instruments					波長: 405nm 375nm、最小描画線幅: 1µm、マスク作製 (Cr、エマルジョン) 、超高速
	B-18	マスクレスアライナ	MLA150	5,374	6,450	4,976	最大8インチ角	直接描画、裏面アライメント
	B-19	i線ステッパ	キヤノン FPA-3030i5+	14,960	29,700	新規	最大8インチ	小片~8インチ、最小線幅 0.35μm以下、重ね合せ精度 40nm、両面アライメント対応、透明基板対応、反り基板対応、Nikonレチクル対応
	D 20	7 /2" o" D H°	C ACC200C2	6 450	12 200	*****	E1007	2~8インチ、HMDS処理、コート 3ライン、現像 2ライン、エッジリンス、バックリンス、ホットプレート
		コータデベロッパ	Suss ACS200Gen3	6,458	13,200	新規	最大8インチ	4セット、クールプレート 1セット
酸	C-01	酸化炉(半導体用)	東京エレクトロン XL-7	10,598	12,716	10,038	最大6インチ	酸化膜形成、半導体ウェハ用
化拡	C-02	酸化炉(MEMS用)	東京エレクトロン XL-7	9,168	11,000	8,608	最大6インチ	酸化膜形成、MEMSウェバ用
散	C-03	P拡散炉	東京エレクトロン XL-7	11,562	13,874	11,002	最大6インチ	P拡散(プリデポ用)
1	C-04	P押し込み炉	東京エレクトロン XL-7	9,854	11,824	9,294	最大6インチ	P拡散(ドライブイン用)
, ,	-	B拡散炉	東京エレクトロン XL-7	10,938			最大6インチ	B拡散(プリデポ用)
ン		B押し込み炉	東京エレクトロン XL-7	9,854	11,824		最大6インチ	B拡散(ドライブイン用)
注入	C-07	アニール炉	東京エレクトロン XL-7	10,112	12,134	9,552	最大6インチ	イオン注入後のアニール
	C-08	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR	19,934	23,922	19,478	最大4インチ	最大加速電圧: 180keV、最大電流: 0.6mA、注入可能元素: P、B、カセットtoカセット
熱処	C-10	ランプアニール装置	AG Associates AG4100	8,522	10,226	7,604	最大6インチ	最高温度: 1100℃、昇温速度: 100℃/sec、カセットtoカセット
理	C-11	メタル拡散炉	光洋リンドバーグ Model270	7,856	9,426	7,890	最大4インチ	最高温度:1000℃、メタルや圧電基板等の多用途拡散
	D-01	LPCVD (SiN)	システムサービス	12,108	14,530	10,368	最大6インチ	SiN
	D-02	LPCVD (Poly-Si)	システムサービス	11,838	14,206	10,362	最大6インチ	Poly-Si
	D-03	LPCVD (SiO2)	システムサービス	12,808	15,368	10,970	最大6インチ	SiO2 (NSG) 、SiON
	D-04	熱CVD	国際電気	21,326	25,590	21,008	最大6インチ	Epipoly-Si(non-doped, doped)、Poly-Si(non-doped, doped)、最高温度:1100℃
	D-05	住友精密PECVD	住友精密 MPX-CVD	15,350	18,420	15,228	最大8インチ	SiN、SiO2、最高温度:350℃、低応力SiN成膜
	D-06	W-CVD	Applied Materials P-5000	9,818	11,782	9,318	4インチ	タングステン成膜
	D-07	アネルバスパッタ装置	アネルバ SPF-730	8,588	10,306	8,560	最大6インチ	1バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3
	D-08	芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII	3,758	4,510	3,734	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板加熱形(最高300℃)
	D-09	電子ビーム蒸着装置	アネルバ EVC-1501	6,838	8,206	6,794	最大6インチ	主に金属薄膜の蒸着
	D-10	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン PZ-604	8,066	9,680	8,028	最大4インチ	PZT成膜
	D-11	めっき装置	山本鍍金試験器	2,546	3,056	2,534	最大6インチ	Cu、Ni、Sn、Au
_45	D-12	MOCVD	ワコム研究所 Doctor T	19,484	23,382	19,320	最大8インチ	PZT成膜等
成膜	D-13	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600	15,156	18,188	14,890	最大6インチ	SiN、SiO2、バッチ式: 4インチ×13枚、6インチ×8枚
	D-14	住友精密TEOS PECVD	VDS-5600 住友精密 MPX-CVD	16,904	20,286	16.784	最大8インチ	TEOS SiO2、SiN、最高温度: 350℃、低応力成膜
			芝浦メカトロニクス					基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、
	D-15	自動搬送 芝浦スパッタ装置	!-Miller CFS-4EP-LL	6,524	7,828	6,344	最大8インチ	自動搬送付
	D-16	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック	4,392	5,270	4,380	球面体	球面体(直径1.0、3.3mm)へのスパッタリング、膜種:Au、Cr、Al、Pd、SiO2他、O2プラズマクリーニング可
	D 47	多元材料原子層堆積(ALD)	= h	10.410	12 500		m 16 % =	
	D-17	装置	テクノファイン ALK-600	10,418	12,502	9,820	最大6インチ	アルミナ等のALDが可能。6インチウェハまでの導入が可能。アルミナ以外は、要原料。
	D-18	酸素加圧RTA付高温スパッタ 装置	ユーテック 21-0604	11,698	14,038	11,650	最大8インチ	金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つの チャンパで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。
	D. 10		マナルバ CDC 250	6 110	7 240	602.	ル	1バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放
	D-19	アネルバマルチスパッタ	アネルバ SPC-350	6,118	7,340	0,034	4インチ	電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ
	D-20	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK	6,450	7,740	新規	最大6インチ	小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可
	D. 24	SPPテクノロジーズ TEOS		16 770	21 507	±c+0	最大8インチ	TEOS SIO2 SIN 其振せイブルト。9 ハエ 皇家海南 250% ばたものNichest
	D-21	PECVD	SPPテクノロジーズ APX-Cetus	16,770	21,507	初功規	四又八01ノナ	TEOS SiO2、SiN、基板サイズ 小片~8インチ、最高温度 350℃、低応力SiN成膜

Poor Depoch (日本日本)		-	-01	DeepRIE装置#1	住友精密 MUC-21	8,054	9,666	8 000	品大6インエ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
Post	チン	-		•						
Paul Public Relia		 -		•						
**** 2-14 1-12		 -								
Feb		-								
Part 1987年 198		-								
****		- 1-					-			
2 - 1-10		 -								
1-10 1-10		-			77777 IPC4000	3,310	3,980	3,2/4	取入01ノナ	
# 0.11 KOHLY-グラ側 3,101 3,722 10ml Micror 場合の			-10	アルバック多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z	10,902	13,082	11,060	最大6インチ	
1			-11	KOHエッチング槽		3,100	3,722	3,084	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
1.1 1.			-12	TMAHエッチング槽		3,112	3,734	3,094	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
Foot Part		E	-13	DeepRIE装置#4	住友精密 MUC-21	14,770	17,724	14,700	最大8インチ	Siの深堀エッチング、静電チャック
Full		E	-14	イオンミリング装置	エヌ・エス/伯東 20IBE-C	11,360	13,632	11,342	最大6インチ	Arイオン、4インチ×6枚、6インチ×3枚
Fig. 17		Е	-15	Vapor HFエッチング装置	住友精密 Primaxx uEtch	8,534	10,240	8,484	最大8インチ	気相フッ酸による主にSiO2犠牲層エッチング
5-11		E	-16	アルバックICP-RIE#1	アルバック NE-550	15,970	19,166	15,820	最大6インチ	
E-11		ŀ				-	-			
Fig. 19		Е	-17	ケミカルドライエッチャー(CDE)	芝浦メカトロニクス CDE7	5,976	7,172	5,954	最大4インチ	
Feb プリルグッパートには2 プレックに-Sout 15,684 18,820 15,694 18,820 15,694 18,820 15,694 18,820 15,694 18,820 15,694 18,820 15,694 18,820 18		E	-18	プラズマクリーナー	ヤマト科学 PDC210	3,198	3,838	3,182	最大6インチ	O2またはArによるウェハ表面のプラズマクリーニング、レジストアッシング
Pol		-	- 40	7" I" HICD DIE "2	711 15b CE 2007	15.604	10.020	45 404	E I C O T	SiO2,メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス:CF4、CHF3、SF6、Ar、O2、
Part					アルハツク CE-3001	· ·				
Food デスフ・ダイザ デスカ DAD-522 2,646 3,176 2,000 BAP6-79 別所 ** 水池水 FOO レーザイーカ OSI JE-DO ZWH-II 2,436 2,922 2,444 1,799 Al. Au IF FOO インデフ・プリードのできる。 67-72 JURINERSE BIO BRY-2/DE - Biolo 2 2,120 2,544 2,100 BAR6-75 SI SIO2, abactorium, CMP IF FOO インデフ・プリードン JURINERSE BIO BRY-2/DE - Biolo 2 3,418 4,102 3,418 BAR6-75 SI SIO2, abactorium, CMP IF FOO インデフ JURIS ABBRIT STO 6,512 7,336 5,400 BAR6-75 BIO STORIUM CMP IF FIG. BEY-7 JURIS ABBRIT STO 6,502 4,000 BAR6-77 BIO BAR6-76 PIRE BEY-7 JURIS ABBRIT STORIUM CMP IF FIG. BEY-7 JURIS ABBRIT STORIUM CMP 7,000 BAR6-77 1,000 BAR6-77 BIO BAR6-77 AIR BAR6-77 BIO BAR6-77 BIO BAR6-77 B		-								
## Prof. クイヤボンダ West Bord		-								
FoS レーザマーカ	#				ディスコ DAD-522	2,646	3,176	2,608	最大6インチ	切削水:水道水
# FOG			-04	ワイヤボンダ	West Bond	1,186	1,424	1,176	チップ	Al, Au
F-07 インテクリの研究機画			-05	レーザマーカ	GSI ルモニクス WM-II	2,436	2,922	2,414	4インチ	ウェノハのマーキング
・「「「 4-クチンと小原義養養		- 11	-06	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni62	2,120	2,544	2,104	最大6インチ	Si、SiO2、金属などの研磨、CMP
FOR DEVG プリリ接合装置	,		-07	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni52	1,822	2,186	1,808	最大4インチ	Si、SiO2、金属などの研磨、CMP
6 「			-08	サンドブラスト	新東	3,418	4,102	3,416	最大6インチ	ガラスの穴あけ加工
F-11 EVG '91/世後を用アライナ EVG Smart View Aligner 5,302 6,362 4,500 8x85cP R改通サアイメト可能 R2を開発するという。		15	-09	EVG ウェハ接合装置	EVG 520	6,112	7,336	5,400	最大8インチ	熱圧着接合用
F-12 熱インブント装置 オリジー電気 Reprina-TSOA 5,900 7,880 5,464 組入バーナル 成人50℃、最大30kM かからまた。			-10	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner	5,302	6,362	4,600	最大8インチ	IR透過アライメント可能
19			-11	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50	6,638	7,964	6,022	最大4インチ角	UV光を用いたインブリント装置、ステップ&リピート可能
F-14 サーフェイスフレナー			-12	熱インプリント装置	オリジン電気 Reprina-T50A	5,900	7,080	5,464	最大2インチ角	最大650℃、最大30kN
F-16 EVG プラズマ活性化機圏 EVG 810 8,018 9,622 7,518 組入60-P 面接接合前のプラズマ活性化処理 標準方式:N2 1,976 2,372 1,964 組入60-P コルドル・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	9	F	-13	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ EXC-1201-DN	2,700	3,240	2,412	最大4インチ	ウェハや石英モールド上の有機物の除去
G-01 プリプラを発音器		F	-14	サーフェイスプレナー	ディスコ DAS8920	14,974	17,968	14,386	4、8インチ	Au、Cuバンプの平坦化
G-02 展界計		F	-16	EVG プラズマ活性化装置	EVG 810	8,018	9,622	7,918	最大6インチ	直接接合前のプラズマ活性化処理 標準ガス:N2
G-03		C	G-01	ウェハゴミ検査装置	トプコン WM-3	1,976	2,372	1,964	最大6インチ	ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ)
G-04 Tencor 段差計 Tencor AlphaStep 500 1,658 1,990 1,648 8大6インチ 1,074 1,290 1,064 8大6インチ 大学式の非路地深之測定装置 1,074 1,290 1,064 8大6インチ 大学式の非路地深之測定装置 1,076 1,290 1,064 8大6インチ 力がし抵抗率などの測定 1,074 1,190 1		C	G-02	膜厚計	ナノメトリクス NanoSpec3000	1,384	1,662	1,370	最大6インチ	光学式の膜厚測定
G-05 深き測定装置 ユニカ光学 Hisomet 1,074 1,290 1,064 株本行子 光学式の非接触深を測定装置 G-06 4探針測定装置 Solid State Measurements SMI50 2,616 3,140 2,606 小外 不軽物濃度プロアイルの創定、フェルを小叶にして端面を斜め細胞した後に測定 G-08 プレプローバ 東京精密 EH-20A 2,666 3,198 2,650 インチ デバイスの電気特性測定 G-09 金属顕微鏡 ユンレ L150 1,152 1,382 1,140 ax647-ア パター受験際、デジの小毒機存・電動ステージ (PC制御可)、20~200倍、500~5000 信息 G-10 デジ外ル顕微鏡 キーエンス/ウノーテクノクラフト 1,540 1,848 1,330 ax467-ア パター砂酸原、デジの小毒機存・電動ステージ (PC制御可)、20~200倍、500~5000 信息 G-11 財産子SEM 目立 S3700N 2,632 3,158 2,228 ax12/-ア・PC (PC)・対験原、デジの小毒機存・電動ステージ (PC制御可)、20~200倍、500~5000 信息 G-12 FE-SEM 目立 S5000 4,622 5,546 4,600 か片 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM G-13 マイクロスキャンラックスの信息 3,324 3,988 3,298 ax467-ア X級を用いた非確認のが解析FESEM G-14 エリフツ アルバウ・ドラックスの信息 3,424 3,482 ax42-ア・デンが高のののが高がにままままままままままままままままままままままままままままままま		C	G-03	Dektak 段差計	Dektak 8	1,658	1,990	1,648	最大6インチ	触針式の表面形状測定
G-06 4探針測定装置		G	G-04	Tencor 段差計	Tencor AlphaStep 500	1,658	1,990	1,648	最大6インチ	触針式の表面形状測定
G-07 拡がり抵抗測定装置 Solid State Measurements SSM150		G	G-05	深さ測定装置	ユニオン光学 Hisomet	1,074	1,290	1,064	最大6インチ	光学式の非接触深さ測定装置
G-07 出かり成功側上表領		G	G-06	4探針測定装置		1,076	1,290	1,064	最大6インチ	ウェハ抵抗率などの測定
G-08 フェノンプローバ 東京精密 EM-20A 2,666 3,198 2,650 4/2チ デバイスの電気特性測定 デバイスの電気特性測定 G-09 金属顕微鏡 コン L150 1,152 1,382 1,140 最大もイナ パター・観察、デジリル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000 G-10 禁電子SEM 日立 S3700N 2,632 3,158 2,528 最大もイナ イター・世界・アグリン教育 EDX付、佐真空モード付、光学画像ナビゲーション付 中に専用、インレンズ式の高分解能FESEM 日立 S5000 4,622 5,546 4,600 小片 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 日立 S5000 7ルパック 972 1,166 960 最大もインチ 海臓の厚き、屈折率測定 G-14 エリプソ アルバック 972 1,166 960 最大もインチ 7がイス内部の手段壊検査・ウェリ接合面の欠陥、ポイド評価等 インサイト IS-350 2,284 2,742 2,272 最大もインチ 大型の大解聴・10μm 日本			G-07	拡がり抵抗測定装置		2,616	3.140	2,606	小片	不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定
G-09 金属顕微鏡 二ン L150 1,152 1,382 1,140 個大647手 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ (PC制御可)、20~200億、500~5000 億・500 長611 熱電子SEM 日立 S3700N 1,540 1,848 1,550 個大847手 倍 日立 S3700N 2,632 3,158 2,528 個大1242手 巨DX付、低度空モード付、光学画像十ゼグーション付 倍 D147 未やデラク ScanXmate D160TS110 1,324 場大647手 水線車 株647手 水線を用いた非破壊内部観察 1,324 場大647手 水線車 株647手 水線車 株647手 水線車 株647手 水線車 株647手 水線車 株647手 水線車 株647手 地画像子とり、長かけ解除:10 Jum 中国では、大り大り大り上部 大り大り大り上部 大り大り大り大り大り 大り大り大り 大り大り大り 大り大り		-				-	•			
G-10 デジタル顕微鏡 キーエンス/ウノーテクJクラフト 1,540 1,848 1,530 最大名子 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍倍 G-11 熱電子SEM 日立 S3700N 2,632 3,158 2,528 最大12インチ EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付 G-12 FE-SEM 日立 S5000 4,622 5,546 4,600 小州 明朝、インレス式の高分解能FESEM G-13 マイクロX線CT コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 3,324 3,988 3,298 最大6インチ X線を用した非破壊内御観察 G-14 エリプソ アルバック 972 1,166 960 最大6インチ 瀬豚の厚き、屈折率測定 G-15 超音波顕微鏡 インサイト IS-350 2,284 2,742 2,272 最大12インチ デイイス内の動の非破壊検査・ウェル接合面の欠陥、ボイド評価等 G-16 デジタルサーモ顕微鏡 アビステ FSV-1200 1,248 1,496 1,236 最大6インチ 両面アライメントの確認、ウェル接合面の水イド評価等 G-18 四重極質量分析装置 オリンバス/浜松木・ナウス・アルバ 1,226 1,472 1,216 プレセス・ウラ プレセカの残留がスのモニタ等 G-22 卓上型エリプリ フォトニックラティス SE-101 746 896 736 最大6インチ 高速サンプルでの残留なおりにしてが、高速とのできたの高速を対策、レーザ光 / 白		 -			-					
G-10		-				-				
G-12 FE-SEM 日立 S5000 4,622 5,546 4,600 小片 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM コムスキャンテクノ ScanXmate コムスキャンテク ScanXmate コムスキャン		C	G-10	テジタル顕微鏡	キーエンス/クノーテクノクラフト	1,540	1,848	1,530	最大8インチ	
### G-13 マイクロX線CT コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 3,324 3,988 3,298 最大6インチ X線を用いた非破壊内部観察 3,298 最大6インチ 薄膜の厚さ、屈折率測定 G-14 エリプソ アルバック 972 1,166 960 最大6インチ 薄膜の厚さ、屈折率測定 G-15 超音波顕微鏡 インサイト IS-350 2,284 2,742 2,272 最大12インチ デバイス内部の非破壊検査、ウエリ接合面の欠陥、ボイド評価等 デジタルサーモ顕微鏡 アビステ FSV-1200 1,248 1,496 1,236 最大6インチ 熱画像センサ、最小分解能:10μm		C	G-11	熱電子SEM	日立 S3700N	2,632	3,158	2,528	最大12インチ	EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付
### 1,000 1,000		C	G-12	FE-SEM	日立 S5000	4,622	5,546	4,600	小片	小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM
10		C	G-13	マイクロX線CT		3,324	3,988	3,298	最大6インチ	X線を用いた非破壊内部観察
G-15 超音波顕微鏡 インサイト IS-350 2,284 2,772 2,272 最大5(インチ 元) 元(ストラン・		y c				-	•		最大6インチ	
G-16 デジタルサーモ顕微鏡 アビステ FSV-1200 1,248 1,496 1,236 最大6インチ 熱画像センサ、最小分解能:10µm G-17 赤外線顕微鏡 オリンパス/浜松木トニクス 1,236 1,482 1,222 最大6インチ 両面アライメントの確認、ウェ八接合面のボイド評価等 G-18 四重極質量分析装置 キャノンアネルバ M-101QA-TDM 1,226 1,472 1,216 プロセス中の残留ガスのモニタ等 G-20 クイックコータ サンユー電子 SC-701MkII 1,338 1,606 1,324 最大2インチ SEM観察試料のPtコーティング G-22 卓上型エリプソ フォトニックラティス SE-101 746 896 736 最大6インチ 高速サンプリング可能なエリプソ G-24 レーザ/白色共焦点顕微鏡 レーザーラック OPTELICS HYBRID LS-SD 4,728 5,674 4,718 最大6インチ 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 G-25 直線集束ビーム超音波材料解析を表現また 3,488 4,184 3,460 最大6インチ 国体試料の漏洩弾性表面波(LSAW)速度測定 G-26 FIB SII SMI9200 9,596 11,516 9,574 小片 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 G-28 XRD ブルカーエイエックスエス D8 DISCOVER 5,154 6,184 5,688 最大6インチ X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能		Ε Η								
G-17 赤外線顕微鏡 オリンパス/浜松木トニクス 1,236 1,482 1,222 最大6インチ 両面アライメントの確認、ウェバ接合面のボイド評価等 G-18 四重極質量分析装置 キヤンアネルバ M-101QA-TDM 1,226 1,472 1,216 プロセス中の残留ガスのモニタ等 G-20 クイックコータ サンユー電子 SC-701MkII 1,338 1,606 1,324 最大2インチ SEM観察試料のPtコーティング G-22 卓上型エリプソ フォトニックラティス SE-101 746 896 736 最大6インチ 高速サンプリング可能なエリプソ G-24 レーザ/白色共焦点顕微鏡 レーザーデック OPTELICS HYBRID LS-SD 4,728 5,674 4,718 最大6インチ 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非 共焦点の切替可能 G-25 直線集束ビーム超音波材料解析システム#1 同線集束ビーム超音波材料解析システム#2 3,488 4,184 3,460 最大6インチ 固体試料の/バルク波(縦波、横波)音速測定 G-27 FIB SII SMI9200 9,596 11,516 9,574 小片 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 G-28 XRD ブルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER 5,154 6,184 5,688 最大6インチ X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能		- F								
G-18 四重極質量分析装置 キャノンアネルバ M-101QA-TDM 1,226 1,472 1,216 プロセス中の残留ガスのモニタ等 G-20 クイックコータ サンユー電子 SC-701MkII 1,338 1,606 1,324 最大2インチ SEM観察試料のPtコーティング G-22 卓上型エリプソ フォトニックラティス SE-101 746 896 736 最大6インチ 高速サンプリング可能なエリプソ G-24 レーザ/白色共焦点顕微鏡 レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD 4,728 5,674 4,718 最大6インチ 共焦点の切替可能 G-25 仮象集束ピーム超音波材料解 ガシステム#1 3,488 4,184 3,460 最大6インチ 固体試料の漏洩弾性表面波(LSAW)速度測定 G-26 桁システム#1 直線集束ピーム超音波材料解 がシステム#1 3,488 4,184 3,460 最大8インチ 固体試料の/バルク波(縦波、横波)音速測定 G-27 FIB SII SMI9200 9,596 11,516 9,574 小片 集束イオンピームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 7ルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER 5,154 6,184 5,688 最大6インチ X線回折測定、1000℃までの高温環境での測定可能		\vdash								
G-18 四里極質量 が		H			·	-			AX/NUTI ノア	
G-22 卓上型エリプソ フォトニックラティス SE-101 746 896 736 最大6インチ 高速サンプリング可能なエリプソ コ次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非 共焦点の切替可能 3,488 4,184 3,460 最大6インチ 国線集東ピーム超音波材料解 析システム#1 百線集東ピーム超音波材料解 3,488 4,184 3,460 最大8インチ 国体試料の漏洩弾性表面波(LSAW)速度測定 場か、ステム#2 日本に対しているでは、対したのでは、対したいでは、対したいでは、対したのでは、対したいでは、対したのでは、対したいでは、対したのでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対しないでは、対し		G	18-د	四重極質量分析装置			1,472	1,216		ノロセス中の残留カスのモニタ等
G-24 レーザ/白色共焦点顕微鏡 OPTELICS HYBRID LS-SD 4,728 5,674 4,718 最大61ンチ		C	G-20	クイックコータ	サンユー電子 SC-701MkII	1,338	1,606	1,324	最大2インチ	SEM観察試料のPtコーティング
G-24 レーザノ 日色共焦点顕微鏡 G-25 直線集束ビーム超音波材料解		C	G-22	卓上型エリプソ		746	896	736	最大6インチ	
G-25 直線集束ビーム超音波材料解		C	G-24	レーザ/白色共焦点顕微鏡		4,728	5,674	4,718	最大6インチ	3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の打替可能
G-25 析システム#1 G-26 直線集束ビーム超音波材料解		H			OL LETTOS LILBKIN F2-2N		-	2 /	日土6 0 7	
G-2b 折システム#2 3,488 4,184 3,460 (東大872) (国体試料のバルク液 (報液、構液) 首座測定 G-27 FIB SII SMI9200 9,596 11,516 9,574 小片 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 G-28 XRD ブルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER 5,154 6,184 5,688 最大6インチ X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能		C	o-25	析システム#1		3,488	4,184	3,460	破大6インチ	回行和科の補洩性性衣囲液(LSAW)速度測定
G-27 FIB SII SMI9200 9,596 11,516 9,574 小片 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製		C	G-26			3,488	4,184	3,460	最大8インチ	固体試料のバルク波(縦波、横波)音速測定
G-28 XRD ブルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER 5,154 6,184 5,688 最大6インチ X線回折測定、1000℃までの高温環境での測定可能		c	G-27		SII SMI9200	9,596	11,516	9,574	小片	集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製
DISCOVER 7,500 7,500		H			ブルカー・エイエックスエス D8	-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G-29 JEOL FE-SEM 日本電子 JSM-6335F 5,330 6,396 新規 最大4インチ 電界放出型SEM、EDX付					DISCOVER	2,134	0,104	5,000		washing the confidence of the
		C	G-29	JEOL FE-SEM	日本電子 JSM-6335F	5,330	6,396	新規	最大4インチ	電界放出型SEM、EDX付